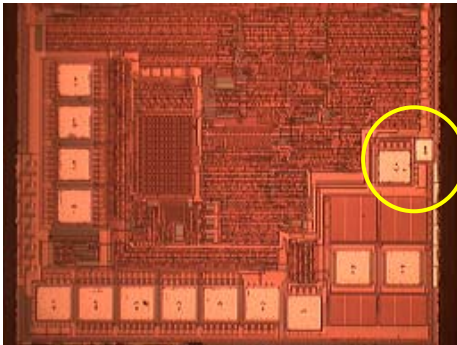


## NY4A & NY4B 邦定注意事項

**說明:**

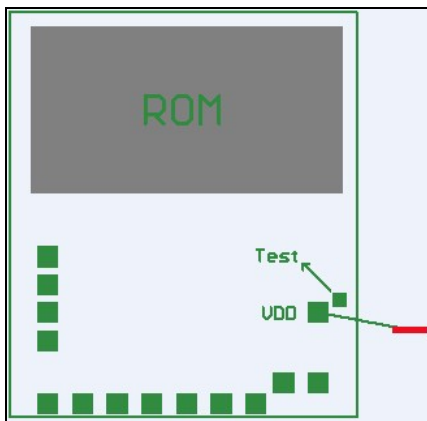
NY4A/NY4B 系列 IC 是在 Test Pad 為高電位時進入 Test Mode，由於 IC Layout 設計時因為 VDD 的 Pad 很接近 Test Pad。所以客戶在 PCB Layout 和邦定時，如果 PCB 上金手指的位置不對，則在邦定時打到 VDD 的鉛線有機會短路到 Test Pad，造成 IC 進入 Test Mode，導致工作不正常。

下圖是 NY4B 的 Pad 位置圖，黃色圓圈中較大的 PAD 為 VDD，較小的為 Test Pad。

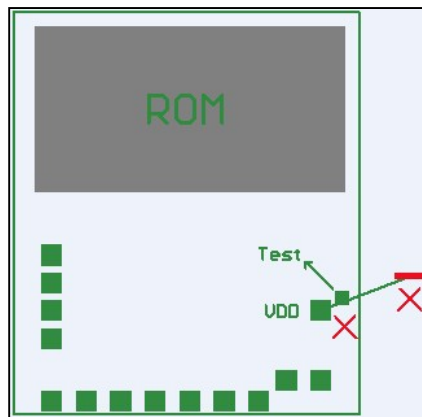


**邦定注意說明:**

在 PCB Layout 時，PCB 上的 VDD 金手指應盡量放在 IC VDD Pad 的右下方，這樣打線的線頭就不容易接觸到 Test Pad。如果金手指平放在正對 VDD Pad 的位置或者右上方，邦定時邦定線頭容易接觸到 Test Pad，而進入 Test Mode，造成大電流和無功能現象。示意圖如下：



正確的 PCB 金手指擺放位置



錯誤的 PCB 金手指擺放位置

下圖是實際不良品的邦定現象(不良品挑開 VDD 邦線後的剩餘線頭圖片)，與右邊良品圖做比較。

